

证券代码：002845

证券简称：同兴达

## 深圳同兴达科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231026

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	标朴投资 周明巍                      创金合信基金管理有限公司 王鑫 富邦瑞锦 邵正宇                      固禾投资 文雅 光大保德信基金管理有限公司 杨一飞 国金证券 周焕博                      颢升投资 沈海兵 华宸投资 李柏汗                      华西证券 侯悦然 华西证券研究所 卜灿华、胡杨、段相域 景顺长城基金管理有限公司 李南西 九泰基金管理有限公司 赵万隆 君榕资产 陈宇                          紫阁投资 滕兆杰 上海和谐汇一资产管理有限公司 章溢漫 西部利得基金管理有限公司 邢毅哲 兆信基金基金管理有限公司 周宁
<b>时间</b>	2023年10月26日
<b>地点</b>	公司会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	副总裁隆晓燕 投资总监姚拥军 董秘李岑 财务主管赖冬青
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	1、公司未来还会继续对触控显示模组和摄像头模组进行资本支出吗？ 答：公司重大资本开支已经完成，计划不再对触控显示模组和摄像头模组大额资本支出，公司目前主要是要将原有产能稼动起来，基于市场目前产品结构变化，会对公司产品形态进

	<p>行调整，比如对显示触控设备进行升级改造，以适应市场。此外由于昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司用时半年经过初期的设备进厂、调试、测试及验证等环节目前开始正式进入量产阶段，后期公司预计会对芯片金凸块（GoldBump）全流程封装测试项目部分资本支出，其他项目几乎没有资本支出。</p> <p>Q2：公司昆山同兴达进入量产阶段后有哪些客户？</p> <p>答：昆山同兴达的产品主要应用于显示驱动芯片。昆山同兴达主要目标客户也是目前液晶显示模组业务的重要芯片设计供应商。</p> <p>Q3：目前公司产能情况如何？</p> <p>答：随着市场回暖，公司产能预计将在 11 月恢复历时最高水平，本月底会将现有资源配置到位。</p> <p>Q4：公司产品价格明年会涨价吗？</p> <p>答：目前中小尺寸液晶显示模组产品价格今年的涨价已经完成，公司所有客户价格均有回调，其中公司现有的老项目价格回调已经完成了 2/3,新项目价格也已经回归到新水准，预计 2024 年市场上中小尺寸液晶显示模组产品价格将处于合理水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 26 日